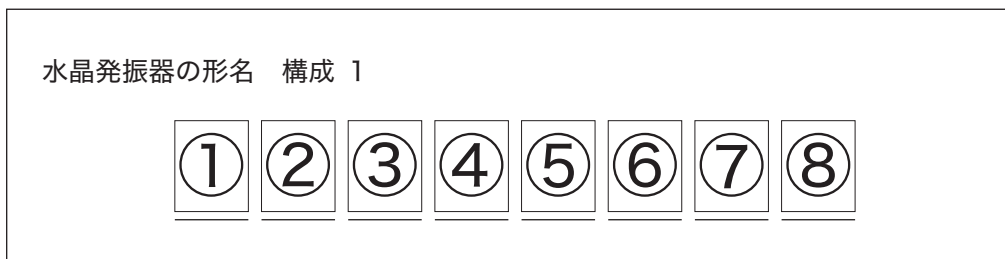


■製品の形名について

当社の水晶発振器製品の形名体系は、外形寸法により以下2種類の如く設定しております。

1. 外形寸法が 10.0mm 未満の場合

(長手、短手いずれも 10mm 未満)



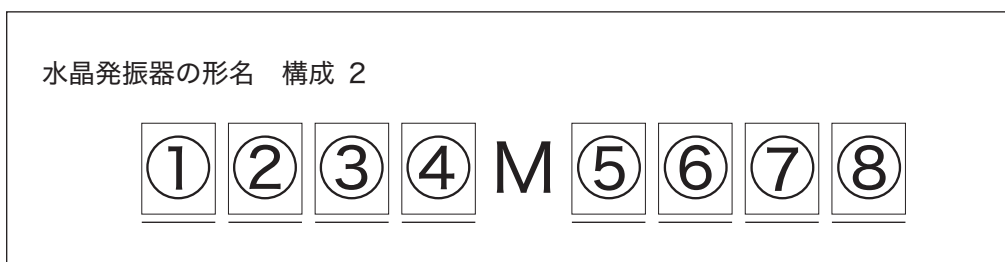
- ① NDKを示す記号：N
- ② 製品を示す記号：表1参照
- ③④ 製品本体の長手方向の公称寸法 (mm) を有効数字2桁で示し、3桁目は四捨五入。
- ⑤⑥ 製品本体の短手方向の公称寸法 (mm) を有効数字2桁で示し、3桁目は四捨五入。

【例】 パッケージ長手寸法 7.0 ± 0.15 …… 記号：70
パッケージ短手寸法 5.0 ± 0.15 …… 記号：50

- ⑦ 封止方法および構造記号：表2参照
- ⑧ 形名登録順の詳細記号：A～Z

2. 外形寸法が 10.0mm 以上の場合

(長手、短手いずれかが 10mm 以上)



- ① NDKを示す記号：N
- ② 製品を示す記号：表1参照
- ③④ 製品本体の長手方向の公称寸法 (mm) を有効数字2桁で示し、3桁目は原則として切り捨てる。
- ⑤⑥ 製品本体の短手方向の公称寸法 (mm) を有効数字2桁で示し、3桁目は原則として切り捨てる。

【例】 パッケージ長手寸法 11.4 ± 0.2 …… 記号：11
パッケージ短手寸法 9.6 ± 0.2 …… 記号：09

- ⑦ 封止方法および構造記号：表2参照
- ⑧ 形名登録順の詳細記号：A～Z

■ 製品の形名について

表 1 製品を示す記号

製品記号	製品
H	恒温槽付き水晶発振器 (OCXO)
P	パッケージ水晶発振器 (SPXO)
T	温度補償水晶発振器 (TCXO)
V	電圧制御水晶発振器 (VCXO)
W	周波数制御水晶発振器 (FCXO)

表 2 封止方法および構造記号

パッケージ区分	製品封止区分	記号	製品封止方法	パッケージ材料	
				ベース	カバー
全製品共通 (発振器以外の製品を含めた 表面実装タイプ)	密封封止	A	金 - 錫はんだ封止	セラミック	金属
		C	接着剤封止	セラミック	
		D	ダイレクトシーム溶接	セラミック	金属
		E	電子ビーム封止	セラミック	金属
		F	樹脂封止	セラミック	樹脂
		M	樹脂モールド	樹脂	
		P	接着剤封止	樹脂	
		G	ガラス封止	セラミック	
		R	抵抗溶接封止	セラミック	金属
	S	シーム溶接	セラミック	金属	
	非密封封止	W	—	基板	金属
		X	—	基板	非金属
		Y	—	モールド	金属
		Z	—	モールド	非金属
特殊	B	プリント基板に複数の水晶素子を搭載 実装し、上面に銘板を貼り付けたもの。			
		リード線端子 ピン端子			
発振器 (表面実装以外)		L			